

最新の レーザテクノロジーで 半導体の製造工程を トータルサポート

ウエハーマーキング



(システム例)

レーザカッティング



リボンボンディング



樹脂成型・バリ取り



レーザはんだ付け



システム化もご相談ください。

ウエハのアニール工程に新しい
レーザ加工技術をご提案します。

ICマーキング・バリ取りに
YVO₄SHG レーザ加工機
ML-9011B



AMADA

株式会社アマダ 微細溶接事業

